

## 2019中国国际智能产业博览会签约530个项目，总投资8169亿元

2019中国国际智能产业博览会8月26日在重庆开幕，并举行了重大项目集中签约仪式。据统计，本届智博会现场集中签约和场外签约项目共530个，合计投资8169亿元，项目数量和投资额均超过首届智博会。

据了解，本届智博会坚持“智能化：为经济赋能，为生活添彩”主题，主要开展“会”“展”“赛”“论”四大板块活动，有来自近60个国家和地区的代表参会，参会嘉宾包括国际组织负责人、国外知名学者和60多位世界500强企业高管等，同时有843家国内外企业参展。

在首届智博会设立智慧体验广场的基础上，今年新增了3个智能实景体验区，还将举行自动驾驶汽车挑战赛、国际无人机竞速大赛、大数据开放创新应用大赛等国际品牌赛事，举行46场论坛活动、100余场发布活动。

重大项目集中签约是智博会的“重头戏”之一。本届智博会共有89个重大项目参加现场集中签约，合计投资2313亿元。其中，重庆市内正式合同项目66个，投资2116亿元，战略框架协议项目14个，投资159亿元。此外，重庆各区县、开发区以及其他省区市还开展了场外签约，签约项目441个，合计投资5856亿元。

这些项目覆盖5G、集成电路、智能终端、人工智能、物联网、工业互联网、新能源及智能网联汽车等领域，涉及英国、德国、新加坡等国家和我国四川、浙江、广东等10余个省区市，展现了智博会在强化国际智能产业开放合作方面的重要平台功能。

原文地址：[http://www.china-nengyuan.com/exhibition/exhibition\\_news\\_144385.html](http://www.china-nengyuan.com/exhibition/exhibition_news_144385.html)